

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants: ISHIHARA, et al.
Filed: April 24, 2001
For: MULTILAYER ELECTRONIC PART, ITS MANUFACTURING
METHOD, TWO-DimensionALLY ARRAYED ELEMENT
PACKAGING STRUCTURE, AND ITS MANUFACTURING
METHOD

CLAIM FOR PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

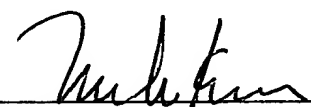
April 24, 2001

Sir:

Under the provisions of 35 USC §119 AND 37 CFR § 1.55,
Applicants hereby claim the right of priority based on Patent
Application No. 10-38726 filed in Japan on October 29, 1998.

Respectfully submitted,

ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP



Melvin Kraus
Registration No. 22,466

1300 North Seventeenth Street
Suite 1800
Arlington, VA 22209
Tel.: 703-312-6600
Fax.: 703-312-6666
MK/alb

THIS PAGE BLANK (USPTO)

REC'D 10 DEC 1999

09/830127
PCT/JP 99/05848

WIPO PCT

日本国特許庁

22.10.99

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1998年10月29日

出願番号

Application Number:

平成10年特許願第308726号

出願人

Applicant(s):

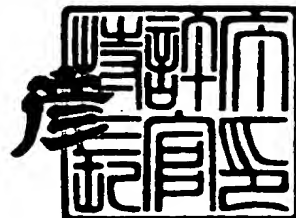
株式会社日立製作所
株式会社日立メディコ

PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

1999年11月26日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤隆彦



出証番号 出証特平11-3081689

【書類名】 特許願

【整理番号】 Y3108

【提出日】 平成10年10月29日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 41/083

【発明の名称】 積層電子部品およびその製造方法および2次元アレイ状の素子実装構造およびその製造方法

【請求項の数】 16

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所 生産技術研究所内

 【氏名】 石原 昌作

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所 生産技術研究所内

 【氏名】 中村 真人

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所 生産技術研究所内

 【氏名】 黒木 喬

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都千代田区内神田一丁目1番14号 株式会社日立メディコ内

 【氏名】 佐野 秀造

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都千代田区内神田一丁目1番14号 株式会社日立メディコ内

 【氏名】 泉 美喜雄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区内神田一丁目1番14号 株式会社日立
メディコ内

【氏名】 大澤 孝也

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区内神田一丁目1番14号 株式会社日立
メディコ内

【氏名】 押木 光博

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社日立製作所

【特許出願人】

【識別番号】 000153498

【氏名又は名称】 株式会社日立メディコ

【代理人】

【識別番号】 100078134

【弁理士】

【氏名又は名称】 武 顕次郎

【電話番号】 03-3591-8550

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006770

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9003102

【包括委任状番号】 9107342

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 積層電子部品およびその製造方法および2次元アレイ状の素子実装構造およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面電極と内部電極と裏面電極とを有し、これらの電極の積層方向の1つおき同士が互いに電氣的に接続されて2つの電極群を構成し、この2つの電極群と電氣的に接続された2つの外部接続用電極部が設けられる積層電子部品であって、

上記積層電子部品の1つの側面において、上記2つの電極群の電氣的接続がなされた構造をとることを特徴とする積層電子部品。

【請求項2】 請求項1記載において、

前記積層電子部品は、チップ状素子と、このチップ状素子の1つの側面に貼着されたフレキシブル基板とによって構成され、

上記フレキシブル基板の電極パターンによって、上記チップ状素子の積層方向の1つおき同士の電極をそれぞれ接続して、前記した2つの電極群を構成するようにしたことを特徴とする積層電子部品。

【請求項3】 請求項2記載において、

前記チップ状素子と前記フレキシブル基板との間の微小隙間に、絶縁性の接着剤を充填したことを特徴とする積層電子部品。

【請求項4】 請求項2記載において、

前記チップ状素子の1つの側面もしくはこの側面の延長上に、前記2つの外部接続用電極部を形成したことを特徴とする積層電子部品。

【請求項5】 請求項4記載において、

前記2つの外部接続用電極部は、前記フレキシブル基板の1対の前記電極パターンの端部によって形成されることを特徴とする積層電子部品。

【請求項6】 請求項2記載において、

前記チップ状素子の前記各電極と前記フレキシブル基板の前記電極パターンとの接続は、厚膜導電ペーストまたはハンダまたは異方導電性シートによって行われることを特徴とする積層電子部品。

【請求項 7】 請求項 2 記載において、

前記チップ状素子の積層方向において隣接する電極同士の導通を遮断するための絶縁パターンを、前記チップ状素子または前記フレキシブル基板に形成したことを特徴とする積層電子部品。

【請求項 8】 表面電極と内部電極と裏面電極とを有するチップ状素子と、このチップ状素子の 1 つの側面に貼着されるフレキシブル基板とによって構成され、上記チップ状素子の積層方向の 1 つおきの電極同士が、上記フレキシブル基板の電極パターンによって互いに電氣的に接続されて 2 つの電極群を構成し、この 2 つの電極群と電氣的に接続された 2 つの外部接続用電極部が、上記フレキシブル基板の電極パターンもしくは該電極パターンと接続された導電部によって形成された積層電子部品の製造方法であって、

上記チップ状素子の母材から、1 チップ相当幅でバー状のサブ母材を切り出す工程と、

上記バー状のサブ母材の長尺側面に、対となる電極パターンを多数形成してなるフレキシブル基板母材を接続・固着して、上記バー状のサブ母材の積層方向の 1 つおきの電極同士の、上記フレキシブル基板母材の各電極パターンで電氣的に接続する工程と、

上記バー状のサブ母材と上記フレキシブル基板母材とが一体化された部材から、個々の積層電子部品を切り出す工程とを、具備したことを特徴とする積層電子部品の製造方法。

【請求項 9】 請求項 8 記載において、

前記チップ状素子の母材の上下に、他の部材を貼着した状態で前記の製造工程を行うことを特徴とする積層電子部品の製造方法。

【請求項 10】 請求項 8 記載において、

前記バー状のサブ母材と前記フレキシブル基板母材とが一体化された部材の状態において、前記バー状のサブ母材と前記フレキシブル基板母材との間の微小隙間に、絶縁性の接着剤を充填することを特徴とする積層電子部品の製造方法。

【請求項 11】 請求項 8 記載において、

前記バー状のサブ母材の長尺側面側において露呈した前記各電極に、接続補助

用のメッキを施すことを特徴とする積層電子部品の製造方法。

【請求項 12】 請求項 8 記載において、

前記フレキシブル基板に、前記バー状のサブ母材の積層方向において隣接する電極同士の導通を遮断するための、絶縁パターンを形成することを特徴とする積層電子部品の製造方法。

【請求項 13】 少なくとも表面電極と裏面電極とを有するチップ状素子と、このチップ状素子の 1 つの側面に貼着されるフレキシブル基板とによって構成され、上記チップ状素子の表面電極および裏面電極が、上記フレキシブル基板の対応する電極パターンと電氣的に接続され、上記表面電極、裏面電極と電氣的に接続された 2 つの外部接続用電極部が、上記フレキシブル基板の電極パターンもしくは該電極パターンと接続された導電部によって形成された電子部品を、縦横に複数個配列して 2 次元アレイ状に一体化したモジュールとしたことを特徴とする 2 次元アレイ状の素子実装構造。

【請求項 14】 請求項 13 記載において、

前記チップ状素子の前記各電極と前記フレキシブル基板の前記電極パターンとの接続は、厚膜導電ペーストまたはハンダまたは異方導電性シートによって行われることを特徴とする 2 次元アレイ状の素子実装構造。

【請求項 15】 請求項 13 記載において、

前記チップ状素子は、表面電極および裏面電極のみを設けた単層構造の素子、または、表面電極と内部電極と裏面電極とを設けた積層構造の素子であることを特徴とする 2 次元アレイ状の素子実装構造。

【請求項 16】 請求項 1 乃至 7 の何れか 1 つに記載の積層電子部品、または、請求項 8 乃至 12 の何れか 1 つに記載の製造方法で作成された積層電子部品の良品のみを、縦横に複数個配列して一体化し、2 次元アレイ状のモジュールを得ることを特徴とする 2 次元アレイ状の素子実装構造の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、積層電子部品およびその製造方法および 2 次元アレイ状の素子実装

構造およびその製造方法に係り、特に例えば、超音波探触装置の高性能化に好適である、2次元アレイ状に配置される多数の圧電セラミック振動素子（積層電子部品）をもつ探触子のための技術に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、圧電セラミック振動素子を用いた超音波送受装置が、各種用途に利用されるようになってきている。なかでも、医療機器においては、X線と比較し人体に不都合を与えずに体内部を観察できる超音波診断法が広く普及している。この超音波診断法に用いられる超音波診断装置には、多数の圧電セラミック振動素子をもつ探触子が超音波送受波器として用いられており、この圧電セラミック振動素子からなる探触子としては、体内部を断層的に画像形成して診断するために、超小型の圧電セラミック振動素子を多数配置してなる走査型探触子が用いられている。

【0003】

このような探触子構造のなかで、圧電セラミック振動素子を1次元に配設した探触子においては、素子が並ぶ方向で使用する素子数を選択することによって、焦点位置を探触子の近傍から遠くまで任意に設定できるが、これと直交する方向では焦点位置が固定となるため、焦点深度に相当する範囲以外では、クリアな断層像を得ることができない。

【0004】

そこで、上記の欠点を解決するために、圧電セラミック振動素子を、1方向だけではなくこれと直交する方向にも配列した、2次元アレイ状の探触子構造が開発され、かような探触子構造は、例えば、1996, IEEE ULTRASONICS SYMPOSIUM pp1523-1526に掲載されている。このような2次元探触子構造では、限られた面積内に、いかに圧電セラミック振動素子を小型化して、高密度に配列するかが、高性能化のキーポイントである。さらに、高密度に配列することと同時に、2次元アレイ状に配列された個々の圧電セラミック振動素子について、素子自身の不良が無くかつ電氣的接続の不良がない、すなわち、探触子を構成する個々の圧電セラミック振動素子の不良がないこ

とが重要である。

【0005】

このような観点から、複数の素子からなるモジュールを単位として、2次元アレイ探触子を構成する手法が、1996 IEEE ULTRASONICS SYMPOSIUM pp1573-1576に掲載されている。この公知文献には、 $0.22\text{ mm} \times 0.22\text{ mm}$ の素子を 64×64 (4096)個配置してなる探触子構造を、2列 \times 64個の素子を1モジュールとして、組み合わせて構築する手法が開示されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記した公知文献による従来のモジュール構造は、各々の圧電セラミック振動素子を駆動するために、フレキシブル配線基板と共通電極を素子面に接続する構成となっており、素子自身が独立した構造ではなくお互いに接着された構造となっている。したがって、モジュールを組み上げた段階で、モジュールを構成している素子のなかに不良素子及び接続不良があっても、素子単位での交換あるいは接続不良の修正を容易に行うことが出来ず、モジュール単位の歩留まりが悪いという問題があった。

【0007】

また、従来のモジュール構造は、各々の圧電セラミック振動素子が単板（単層）の構成であることが前提であり、探触子の性能向上に必要な積層型の圧電セラミック振動素子への適用については、考慮されてはいなかった。

【0008】

さらに、従来の積層型の圧電セラミック振動素子は、図15に示すように、素子の対向する2つの側面に形成した側面電極61によって、表面電極12、セラミックス11内の内部電極13'、裏面電極15の各電極が、積層方向の1つおき同士で互いに電氣的に接続されるよう構成されるか、あるいは図16に示すように、スルーホール内に充填した導電材62によって、表面電極12、内部電極13'、裏面電極15の各電極が、積層方向の1つおき同士で互いに電氣的に接続されるよう構成されていた。このため、製造プロセスが比較的に複雑なものと

なると共に、素子の小型化にも自ずと限界を生じ、かつ、素子の2つの電極群を外部と接続するために、素子の2面を外部接続用の接続面とせざるを得ないため、素子交換および接続修正が困難なものとなっており、前記した探触子への適用には不向きなものとなっていた。

【0009】

本発明は上記の点に鑑みなされたもので、その目的するところは、圧電セラミック振動素子として積層型素子を用いることが可能で、かつ、素子単位で不良素子の交換および接続不良の修正が可能な、2次元アレイ状の探触子（素子実装構造）を提供することにある、また、このような素子実装構造の実現のために好適な圧電セラミック振動素子（積層電子部品）を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】

上記した目的を達成するために、本発明においては、例えば、積層電子部品を、表面電極と内部電極と裏面電極とを有する積層型のチップ状素子と、このチップ状素子の1つの側面に貼着されるフレキシブル基板とによって構成し、チップ状素子の積層方向の1つおきの電極同士を、フレキシブル基板の電極パターンによって互いに電氣的に接続して2つの電極群を形成し、この2つの電極群と電氣的に接続された2つの外部接続用電極部として、例えば、フレキシブル基板の電極パターンの端部を用いるようにされる。そして、上記の積層電子部品を、縦横に複数個配列して一体化してなる2次元アレイ状のモジュールを形成し、このモジュールを必要な数だけ組み合わせて、超音波探触装置用の探触子を構築するようにされる。

【0011】

上記のように、圧電セラミック振動素子として積層型のもの（上記の積層電子部品）を用いると、小型で高性能の探触子を得ることができる。また、個々の積層電子部品（圧電セラミック振動素子）に、それぞれ独立して2つの外部接続用電極部を設ける構成としているので、個々の積層電子部品（圧電セラミック振動素子）に対して、チップ状素子不良、および、外部との接続不良の検査が可能となり、不良積層電子部品の交換及び接続不良の修正が、圧電セラミック振動素子

単位（積層電子部品単位）で容易に行えるようになる。その結果、モジュール不良はなくなり、高歩留まりでモジュールを製造することが可能となる。さらに、チップ状素子の1つの側面で、フレキシブル基板の電極パターンによって、チップ状素子の2つの電極群形成のための接続と、外部接続用電極部の形成とを行うようにしているので、製造プロセスが容易となり、かつ、積層電子部品（圧電セラミック振動素子）の極小化も達成できる。

【0012】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を、図面を用いて説明する。

図1は、本発明の第1実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す図である。同図において、1は積層型のチップ状素子、11はセラミックス、12は表面電極、13は第1の内部電極、14は第2の内部電極、15は裏面電極、16は絶縁パターン、17は導体パターン、18は保護絶縁膜である。

【0013】

本実施形態を含め本発明の各実施形態の積層タイプのチップ状素子1は、図1の(a)に示すように、内部電極13、14を挟んで多層にセラミックス11を積層し、表裏面に表面電極12と裏面電極15を形成した構成をとり、かつ、各電極の平面形状は、総べてセラミックス11の平面形状と等しく形成されたものとなっている。したがって、チップ状素子1の4つの側面において、表面電極12、第1の内部電極13、第2の内部電極14、裏面電極15のそれぞれ端面が、面一で露呈するようになっている。

【0014】

かような基本構成をもつチップ状素子1において、本実施形態では、チップ状素子1の1つの側面において、図1の(b)に示すように、第1の内部電極13および第2の内部電極14がそれぞれ一部だけ露出するように、絶縁パターン16を形成した後、図1の(c)に示すように、各電極12～15の積層方向の1つおき同士を導体パターン17によって電氣的に接続するようにしてある（ここでは、表面電極12と第2の内部電極14を接続し、第1の内部電極13と裏面

電極 15 を接続してある)。そして、図 1 の (d) に示すように、各電極を所定の関係に接続したチップ状素子 1 の側面を、保護絶縁膜 18 によって覆って、積層電子部品として完成するようにしてある。なお本実施形態では、表面電極 12 および裏面電極 15 が、外部接続用の電極として機能するようになっている。

【0015】

このような構成をとる本実施形態の積層電子部品は、チップ状素子 1 の電極 12～15 の積層方向の 1 つおき同士が、チップ状素子 1 の 1 つの側面でそれぞれ接続されるので、各電極 12～15 の平面形状を総べて同一のものとすることができ、図 15 や図 16 に示した従来構造に比して、内部電極の形成および積層位置合わせが容易となり（製造プロセスが容易となり）、かつ、可及的な小型化が達成可能となる。

【0016】

図 2 は、本発明の第 2 実施形態に係る積層電子部品を示す図であり、同図において、先の実施形態と均等なものには同一符号を付し、その説明は必要のある際を除いて割愛する（これは、以下の各実施形態においても同様である）。図 2 において、19 は Ag ペースト、20 はフレキシブル基板、21、22 はフレキシブル基板上に形成した対をなす電極パターンである。

【0017】

本実施形態では、図 2 の (a) に示す如く、先と同様の構成のチップ状素子 1 の 1 つの側面において、図 2 の (b) に示すように、各電極 12～15 におけるフレキシブル基板 20 との接続部位を除いて、絶縁パターン 16 を形成する。そして、図 2 の (c) に示すように、フレキシブル基板 20 の電極パターン 21、22 と、これに対応する各電極 12～15 の露呈部位とを、Ag ペースト 19 によって電氣的に接続して、これによって、各電極 12～15 の積層方向の 1 つおき同士を電氣的に接続するようにしてある（ここでは、表面電極 12 と第 2 の内部電極 14 をフレキシブル基板 20 の電極パターン 21 によって接続し、第 1 の内部電極 13 と裏面電極 15 をフレキシブル基板 20 の電極パターン 22 によって接続してある）。なお、図 2 の (c) は、図 2 の (b) に対して側面図の関係となっており、図 2 の (d) は、フレキシブル基板 20 のパターン形成面を示し

ている。

【0018】

このように、本実施形態では、チップ状素子1とフレキシブル基板20とによって積層電子部品を構成してあり、表面電極12および裏面電極15が、外部接続用の電極として機能するようになっている。なお、チップ状素子1とフレキシブル基板20とを接続する上記のAgペースト19は、チップ状素子1側に形成してもよいし、フレキシブル基板20側に形成してもよい。

【0019】

かような構成をとる本実施形態においても、前記第1実施形態と同等の効果を奏する上、チップ状素子1の電極12～15の積層方向の1つおき同士の接続をフレキシブル基板20で行うので、この点でも製造工程が容易になる。

【0020】

図3は、本発明の第3実施形態に係る積層電子部品を示す図であり、同図において、23はフレキシブル基板20に形成した絶縁パターンである。

【0021】

本実施形態が第2実施形態と相違するのは、第2実施形態においては、チップ状素子1側に、選択的接続を可能とするための絶縁パターン16を形成していたものを、本実施形態においては、フレキシブル基板20のパターン形成面側に、選択的接続を可能とするための絶縁パターン23を形成した点にあり、その他は第2実施形態と同様である。なお、図3の(b)は、図3の(a)に示したチップ状素子1の面が接続面とした場合に、図3の(a)に対して若干拡大した側面図の関係となっており、図3の(c)は、フレキシブル基板20のパターン形成面を示している。

【0022】

かような構成をとる本実施形態においても、前記第2実施形態と同等の効果を奏する。

【0023】

なお、上述した絶縁パターン、導体パターンの形成方法としては、ペーストをスクリーン印刷することでパターンを形成する厚膜法、あるいは、蒸着、スパッ

タ、エッチング等でパターンを形成する薄膜法のいずれの方法でもよい。

【0024】

さらに、フレキシブル基板20の電極パターンと接続されるチップ状素子1の電氣的接続部は、チップ状素子1の電極露出部そのものであっても、あるいは、チップ状素子1の電極上に、厚膜または薄膜で形成した導体パターン部でもあってもよい。また、チップ状素子1の電極と接続されるフレキシブル基板20の電氣的接続部は、フレキシブル基板20の電極パターンそのものであっても、あるいは、フレキシブル基板20の電極パターン上に、厚膜などで形成した導体パターン部でもあってもよい。

【0025】

図4は、本発明の第4実施形態に係る積層電子部品を示す図であり、同図において、24はチップ状素子1の電極露出部上に形成しためっき膜部、25は接続用のハンダである。

【0026】

本実施形態が第3実施形態と相違するのは、図4の(a)に示す如く、先と同様の構成のチップ状素子1の1つの側面において、図4の(b)に示すように、各電極12～15上にめっき膜部24を形成した点と、チップ状素子1とフレキシブル基板20との電氣的接続に、図4の(c)に示すように、チップ状素子1側またはフレキシブル基板20に形成したハンダ25を用いた点にあり、その他は第3実施形態と同様である。なお、図4の(c)は、図4の(b)に対して若干拡大した側面図の関係となっており、図4の(d)は、フレキシブル基板20のパターン形成面を示している。

【0027】

かような構成をとる本実施形態においても、前記第2実施形態と同等の効果を奏する。

【0028】

図5は、本発明の第5実施形態に係る積層電子部品を示す図であり、同図において、26は異方導電性フィルムである。

【0029】

本実施形態が第4実施形態と相違するのは、図5の(a)に示す如く、チップ状素子1とフレキシブル基板20との電氣的接続に、異方導電性フィルム26を用いた点にあり、その他は第4実施形態と同様である。なお、図5の(b)は、フレキシブル基板20のパターン形成面を示している。

【0030】

かような構成をとる本実施形態においても、前記第2実施形態と同等の効果を奏する。

【0031】

なお、チップ状素子1とフレキシブル基板20との電氣的接続は、上述した手段以外にも、場合によっては、ワイヤボンディング、金属拡散接続等の接続方法も採用可能である。

【0032】

図6は、本発明の第6実施形態に係る積層電子部品を示す図であり、同図において、27はフレキシブル基板20を貫通して形成された電極パッドである。

【0033】

本実施形態が第4実施形態と相違するのは、図6の(c)、(d)に示すように、フレキシブル基板20のパターン形成面と反対側の面で露出し、かつ、フレキシブル基板20の電極パターン21、22とそれぞれ接続された電極パッド27、27を、外部接続用の電極とした点にあり、その他は第4実施形態と同様である。

【0034】

かような構成をとる本実施形態においても、前記第2実施形態と同等の効果を奏し、さらに、本実施形態においては、外部接続用の対となった電極を積層電子部品の1つの側面に集約できるので、積層電子部品の外部接続も容易になるという効果がある。

【0035】

次に、上述したような積層電子部品の製造方法、および、これを用いた2次元アレイ状の素子実装構造の製造方法の1例についてを、図7を用いて説明する。

図7は、図4に示した前記第4実施形態に相当する積層電子部品の製造方法と、この積層電子部品を用いた2次元アレイ状の素子実装構造の製造方法を示している。

【0036】

まず、図7の(a)に示すような平板状のチップ状素子母材30から、図7の(b)に示すように、1チップ相当幅でバー状のサブ母材31を切り出す。次に、図7の(c)に示すように、切り出したサブ母材31の所定の長尺側面において露出した各電極12~15の端面上に、めっき膜部24を形成する。

【0037】

一方、図7の(d)に示すように、対となる電極パターン21、22を多数形成してなるフレキシブル基板母材32には、選択的接続を可能とするための絶縁パターン23を形成した後、絶縁パターン23から露呈した電極パターン21、22の各部位に、接続用のハンダ25を形成しておく。

【0038】

次に、図7の(e)に示すように、バー状のサブ母材31とフレキシブル基板母材32の接続面同士を、位置合わせして密着し、加熱処理することによって、サブ母材31とフレキシブル基板母材32の各接続箇所同士を電氣的に接続する。然る後、サブ母材31とフレキシブル基板母材32との間の微小隙間(10~数10 μ mの隙間)に絶縁性の接着剤(例えば、低粘度のウレタン樹脂系接着剤)を充填し、サブ母材31とフレキシブル基板母材32とを強固に機械的に接続する。

【0039】

次に、図7の(f)に示すように、サブ母材31とフレキシブル基板母材32とを一体化した母材から、ダイサーによって、個々の積層電子部品33を切り出すことによって、積層電子部品33が完成される。

【0040】

そして、上記した各工程を経て完成された積層電子部品33を検査して、図7の(g)に示すように、良品のみからなる積層電子部品33を、縦横に所定個数組み合わせさせて樹脂34で一体化することによって、2次元アレイ状探触子のため

のモジュール 35 が作製され、このモジュール 35 を多数個組み合わせることによって、2 次元アレイ状探触子が完成される。

【0041】

このような、モジュール 35 を組み合わせて作製した 2 次元アレイ状探触子は、個々の積層電子部品が小型化できるので、全体として小型化が可能となる。しかし、各積層電子部品の外部接続には相当の工夫を必要とし、以下に述べるような、チップ状素子の側面に貼着されたフレキシブル基板の延長部に、1 対の外部接続用の電極を設けた構成の積層電子部品（もしくは単層タイプの電子部品）の方が、外部接続が容易・確実で、有利である。

【0042】


図 8 は、本発明の第 7 実施形態に係る積層電子部品を示す図であり、本実施形態は、図 2 に示した前記第 2 実施形態の発展例である。

【0043】

本実施形態が第 2 実施形態と相違するのは、チップ状素子 1 の 1 つの側面に接続されたフレキシブル基板 20 に延長部 20a を設けて、チップ状素子 1 の各電極 12～15 の積層方向の 1 つおき同士を電氣的に接続するフレキシブル基板 20 の電極パターン 21、22 の端部を、外部接続用の電極部 21a、22a としたことにあり、その他は第 2 実施形態と同様である。

【0044】

かような構成をとる本実施形態の積層電子部品は、チップ状素子 1 の電極 12～15 の積層方向の 1 つおき同士が、チップ状素子 1 の 1 つの側面でそれぞれ接続されるので、各電極 12～15 の平面形状を総べて同一のものとすることができ、図 15 や図 16 に示した従来構造に比して、内部電極の形成および積層位置合わせが容易となり（製造プロセスが容易となり）、かつ、可及的な小型化が達成可能となる。しかも、チップ状素子 1 の電極 12～15 の積層方向の 1 つおき同士の接続をフレキシブル基板 20 で行うので、この点でも製造工程が容易になる。さらに、フレキシブル基板 20 に延長部 20a を設けて、この延長部 20a 上の電極パターン 21、22 の端部を、外部接続用の電極部 21a、22a として同一方向に導出しているので、積層電子部品の外部接続が容易・確実になり、



多数個の積層電子部品を組み合わせてモジュールとした場合に、その接続性能の良さが遺憾なく発揮される。しかも、積層電子部品の接続不良も、個々に対して個別に容易に対処可能となり、交換もしくは補修を容易・確実に行うことができる。

【0045】

図9は、本発明の第8実施形態に係る積層電子部品を示す図であり、本実施形態は、図3に示した前記第3実施形態の発展例である。本実施形態が第3実施形態と相違するのは、フレキシブル基板20に延長部20aを設けて、延長部20a上の電極パターン21、22の部位を、外部接続用の電極部21a、22aとした点にあり、その他は第3実施形態と同様である。

【0046】

かような構成をとる本実施形態においても、前記第7実施形態と同等の効果を奏する。

【0047】

図10は、本発明の第9実施形態に係る積層電子部品を示す図であり、本実施形態は、図4に示した前記第4実施形態の発展例である。本実施形態が第4実施形態と相違するのは、フレキシブル基板20に延長部20aを設けて、延長部20a上のフレキシブル基板20電極パターン21、22の部位を、外部接続用の電極部21a、22aとした点にあり、その他は第4実施形態と同様である。

【0048】

かような構成をとる本実施形態においても、前記第7実施形態と同等の効果を奏する。

【0049】

図11は、本発明の第10実施形態に係る積層電子部品を示す図であり、本実施形態は、図5に示した前記第5実施形態の発展例である。本実施形態が第5実施形態と相違するのは、フレキシブル基板20に延長部20aを設けて、延長部20a上の電極パターン21、22の部位を、外部接続用の電極部21a、22aとした点にあり、その他は第4実施形態と同様である。

【0050】

かような構成をとる本実施形態においても、前記第7実施形態と同等の効果を奏する。

【0051】

上述してきた第1～第10実施形態では、セラミックスを多層に積層した積層電子部品の例を示した。次に、セラミックスを単層とした単板タイプの圧電セラミック振動素子への適用例について述べる。

【0052】

図12は、本発明の第11実施形態に係る電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す図である。同図において、41は単層（単板）型のチップ状素子であり、単板のセラミックス11には、表面電極12と裏面電極15とが形成されている。チップ状素子41の1つの側面において、表面電極12と裏面電極15には選択的に、絶縁パターン16とめっき膜部24が形成されており、めっき膜部24をフレキシブル基板20の対応する電極パターン21、22と、ハンダ25によって電氣的に接続してある。そして、フレキシブル基板20に延長部20aを設けて、延長部20a上の電極パターン21、22部位を、外部接続用の電極部21a、22aとして機能させるようにしてある。

【0053】

かような構成をとる本実施形態においては、単層（単板）型の圧電セラミック振動素子であるので、積層型の圧電セラミック振動素子と較べて性能は劣るも、フレキシブル基板20に延長部20aを設けて、この延長部20a上のフレキシブル基板20の電極パターン21、22の端部を、外部接続用の電極部21a、22aとして同一方向に導出しているので、積層電子部品の外部接続が容易・確実なものとなり、多数個の積層電子部品を組み合わせモジュールとした場合に、その接続性能の良さが遺憾なく発揮される。しかも、積層電子部品の接続不良も、個々に対して個別に容易に対処可能となり、交換もしくは補修を容易・確実に行うことができる。

【0054】

図13は、本発明の第12実施形態に係る電子部品（圧電セラミック振動素子

）を示す図であり、本実施形態が第 11 実施態と異なるのは、第 11 実施態では単層（単板）型のチップ状素子 41 側に絶縁パターン 16 を設けていたのに対し、フレキシブル基板 20 側に絶縁パターン 23 を形成した点にあり、その他は第 11 実施形態と同様である。

【0055】

かような構成をとる本実施形態においても、第 11 実施形態と同等の効果を奏する。

【0056】

ここで、前述した第 1～第 10 実施形態において示した積層電子部品（圧電セラミック振動素子）は、セラミックスの積層数が 3 層の場合を例にとったが、本発明の積層電子部品におけるセラミックスの積層数は任意である。

【0057】

また、前述した第 2～第 12 実施形態において示した、チップ状素子とフレキシブル基板とによって積層電子部品または電子部品を構成する場合においては、チップ状素子とフレキシブル基板との電氣的接続には、先にも述べたように、ハンダ、熱可塑性ペースト、異方導電性シート等の任意の手段が採用可能であるが、チップ状素子とフレキシブル基板との間の微小隙間には、絶縁性の接着剤（例えば、低粘度のウレタン樹脂系接着剤）を充填しておくことが、機械的強度を確保する上で好ましい。

【0058】

次に、上述したようなフレキシブル基板 20 に延長部 20a に外部接続用の電極部 21a、22a を設けた構成の積層電子部品の製造方法、および、これを用いた 2 次元アレイ状の素子実装構造の製造方法の 1 例についてを、図 14 を用いて説明する。

【0059】

まず、図 14 の（a）に示すように、平板状のチップ状素子母材 30 の上下に、平板状の音響整合層 45 および平板状の音響減衰層 46 を固着して一体化してなるチップ状素子複合母材 47 を用意する。次に、図 14 の（b）に示すように、チップ状素子複合母材 47 から 1 チップ相当幅でバー状のサブ複合母材 48 を

切り出す。

【0060】

次に、図14の(c)に示すように、切り出したバー状のサブ複合母材48の所定の長尺側面において露出した各電極12～15の端面上に、まず、Niめっきを施し、このNiめっき表面にAuめっきを施すことによって、めっき膜部24を形成する。

【0061】

一方、図14の(d)に示すように、対となる電極パターン21、22を多数形成してなるフレキシブル基板母材49には、選択的接続を可能とするための絶縁パターンを形成した後、絶縁パターンから露呈した電極パターン21、22の各部位に、接続用のハンダ25を形成しておくと共に、フレキシブル基板母材49の延長部49aに、対となる電極パターン21、22とそれぞれ連なった外部接続用の電極部21a、22aを形成しておく。そして、バー状のサブ複合母材48とフレキシブル基板母材49の接続面同士を、位置合わせして密着し、加熱処理することによって、サブ複合母材48とフレキシブル基板母材49の各接続箇所同士を電氣的に接続する。然る後、サブ複合母材48とフレキシブル基板母材49との間の微小隙間(10～数10 μ mの隙間)に絶縁性の接着剤(例えば、低粘度のウレタン樹脂系接着剤)を充填し、サブ複合母材48とフレキシブル基板母材49とを強固に機械的に接続する。

【0062】

次に、図7の(e-1)、(e-2)に示すように、サブ複合母材48とフレキシブル基板母材49とを一体化した母材から、ダイサーによって、個々の積層電子部品50を切り出すことによって、音響整合層45および音響減衰層46付きの積層電子部品(セラミック振動素子)50が完成される。

【0063】

そして、上記した各工程を経て完成された積層電子部品50を検査して、図14の(f)に示すように、良品のみからなる積層電子部品50を、縦横に所定個数組み合わせて樹脂51で一体化することによって、2次元アレイ状探触子のためのモジュール52が作製される。続いて、これらモジュール52の各積層電子

部品 50 の検査を行う。上述したように、個々の積層電子部品 50 の 1 つの側面で電極を接続した構造とすること、および、接続部にハンダ、熱可塑性ペースト、異方導電性シート等を使用することによって、通常の L S I など半導体素子と同様に、素子単位で不良素子の交換及び接続不良の修正が容易に行える。

【0064】

最後に、上記モジュール 52 の良品のみを多数個組み合わせることによって、2 次元アレイ状探触子が完成される。なお本例では、15 mm×15 mm に 64×64 個の積層電子部品 50 が並んだ 2 次元アレイ状探触子を、64 個の素子からなるモジュール 52 を 64 枚並べて作製した。

【0065】

なお、図 14 に示した例では、積層圧電セラミック素子（積層電子部品）の場合について述べたが、図 12、図 13 に示したような、単層の圧電セラミック素子（単層の電子部品）についても、同様の方法で 2 次元アレイ状探触子が作製できること言うまでもない。

【0066】

また、音響整合層および音響減衰層の接着についても、特に図 14 の製造工程に限定されるものでなく、例えば、積層圧電セラミック素子（積層電子部品）をマトリックス状に整列させてから、積層圧電セラミック素子に音響整合層および音響減衰層を固着するようにしてもよい。

【0067】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、圧電セラミック振動素子として積層型素子を用いることが可能で、かつ、素子単位で不良素子の交換および接続不良の修正が可能な、2 次元アレイ状の探触子（素子実装構造）を実現でき、また、このような素子実装構造の実現のために好適な圧電セラミック振動素子（積層電子部品）を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す

説明図である。

【図 2】

本発明の第 2 実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 3】

本発明の第 3 実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 4】

本発明の第 4 実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 5】

本発明の第 5 実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 6】

本発明の第 6 実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 7】

本発明の実施形態による積層電子部品の製造方法、および、これを用いた 2 次元アレイ状の素子実装構造の製造方法の 1 例を示す説明図である。

【図 8】

本発明の第 7 実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 9】

本発明の第 8 実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 10】

本発明の第 9 実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 11】

本発明の第 10 実施形態に係る積層電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 12】

本発明の第 11 実施形態に係る単層タイプの電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 13】

本発明の第 12 実施形態に係る単層タイプの電子部品（圧電セラミック振動素子）を示す説明図である。

【図 14】

本発明の実施形態による積層電子部品の製造方法、および、これを用いた 2 次元アレイ状の素子実装構造の製造方法の他の 1 例を示す説明図である。

【図 15】

従来の積層電子部品（圧電セラミック振動素子）の 1 例を示す説明図である。

【図 16】

従来の積層電子部品（圧電セラミック振動素子）の他の 1 例を示す説明図である。

【符号の説明】

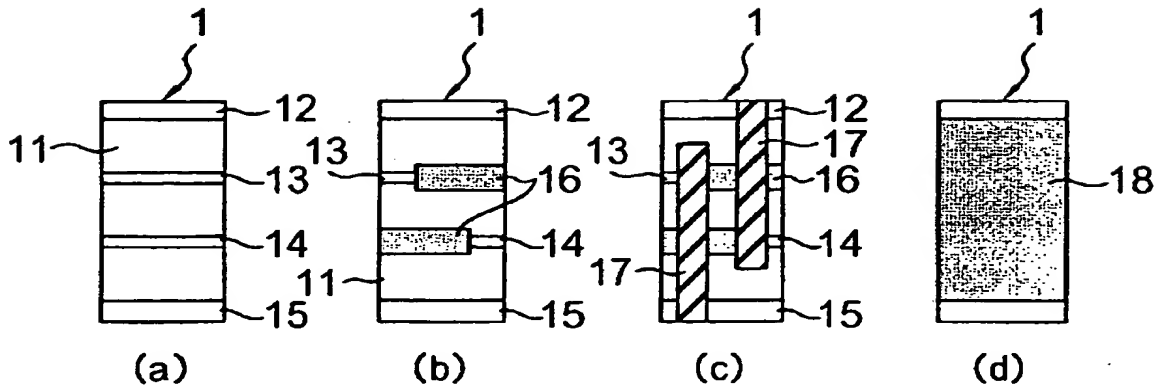
- 1 積層型のチップ状素子
- 11 セラミック
- 12 表面電極
- 13 第 1 の内部電極
- 14 第 2 の内部電極
- 15 裏面電極
- 16 絶縁パターン
- 17 導体パターン
- 18 保護絶縁膜
- 19 Ag ペースト
- 20 フレキシブル基板

- 20a 延長部
- 21、22 電極パターン
 - 21a、22a 外部接続用の電極部
- 23 絶縁パターン
- 24 めっき膜部
- 25 ハンダ
- 26 異方導電性フィルム
- 30 チップ状素子母材
- 31 サブ母材
- 32 フレキシブル基板母材
- 33 積層電子部品
- 34 樹脂
- 35 モジュール
- 41 単層（単板）型のチップ状素子
- 45 音響整合層
- 46 音響減衰層
- 47 チップ状素子複合母材
- 48 サブ複合母材
- 49 フレキシブル基板母材
- 50 積層電子部品
- 51 樹脂
- 52 モジュール

【書類名】 図面

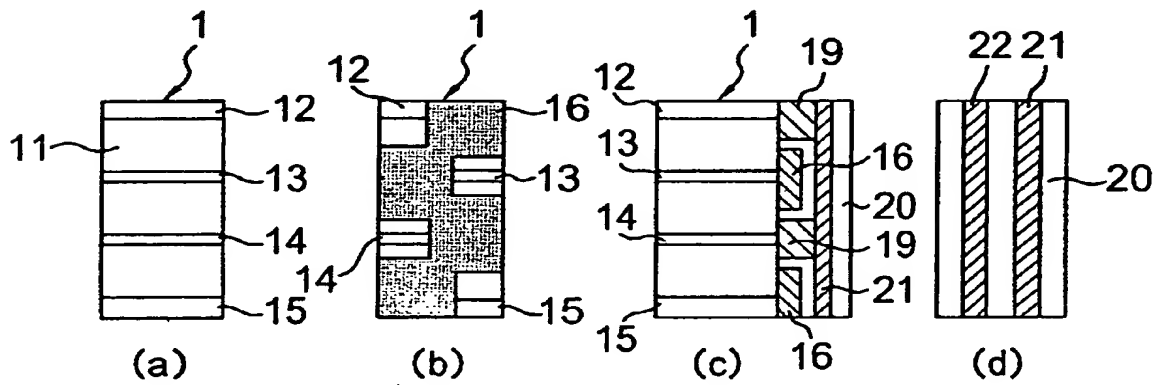
【図 1】

【図 1】



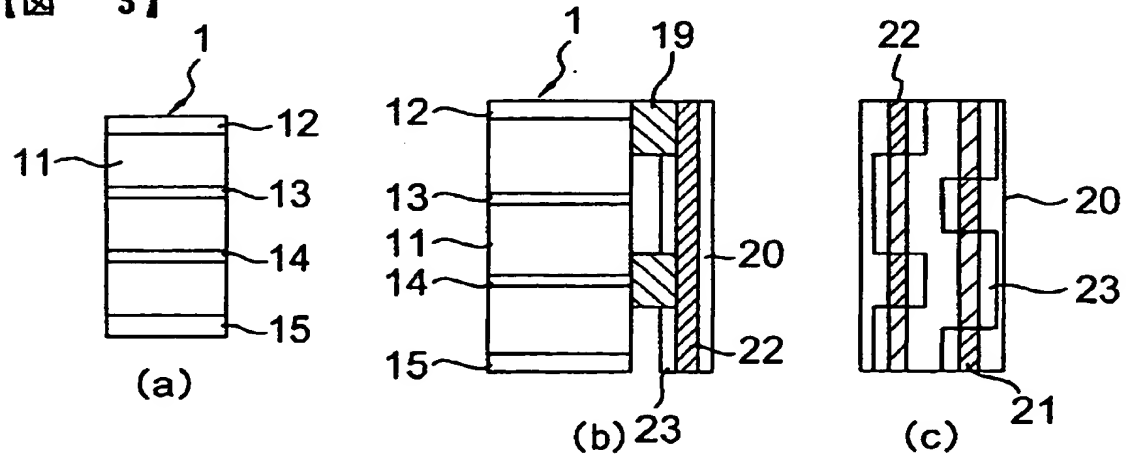
【図 2】

【図 2】



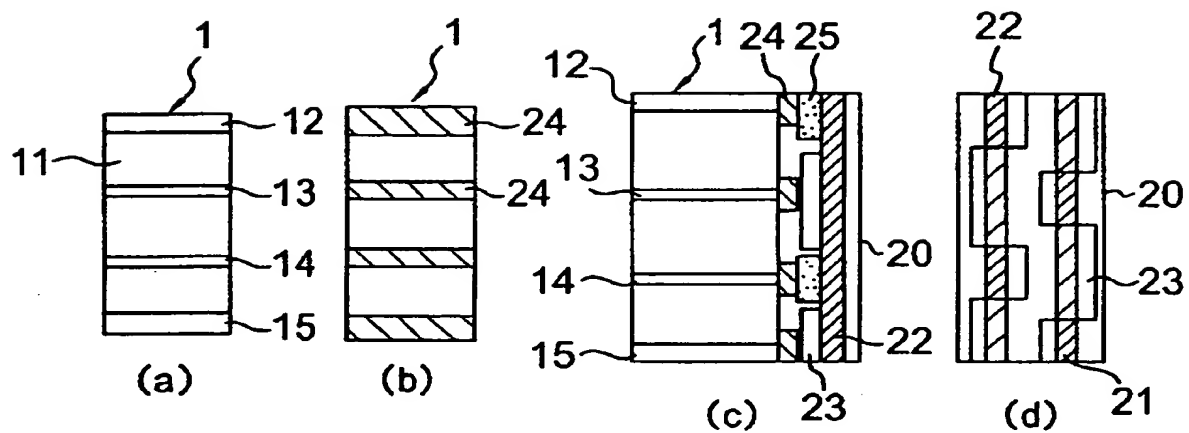
【図 3】

【図 3】



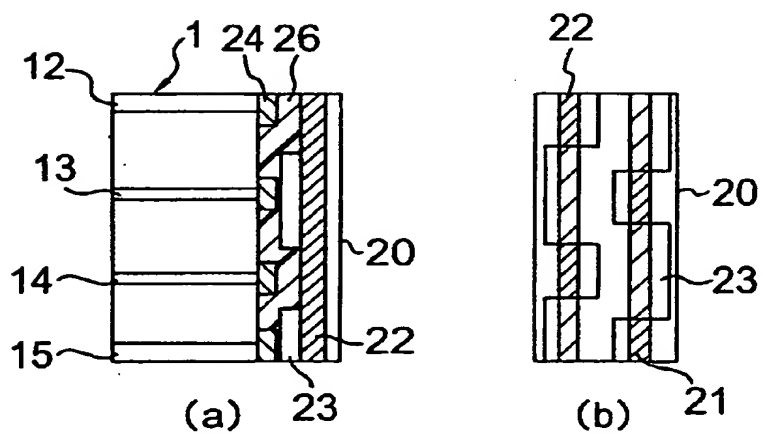
【図 4】

【図 4】



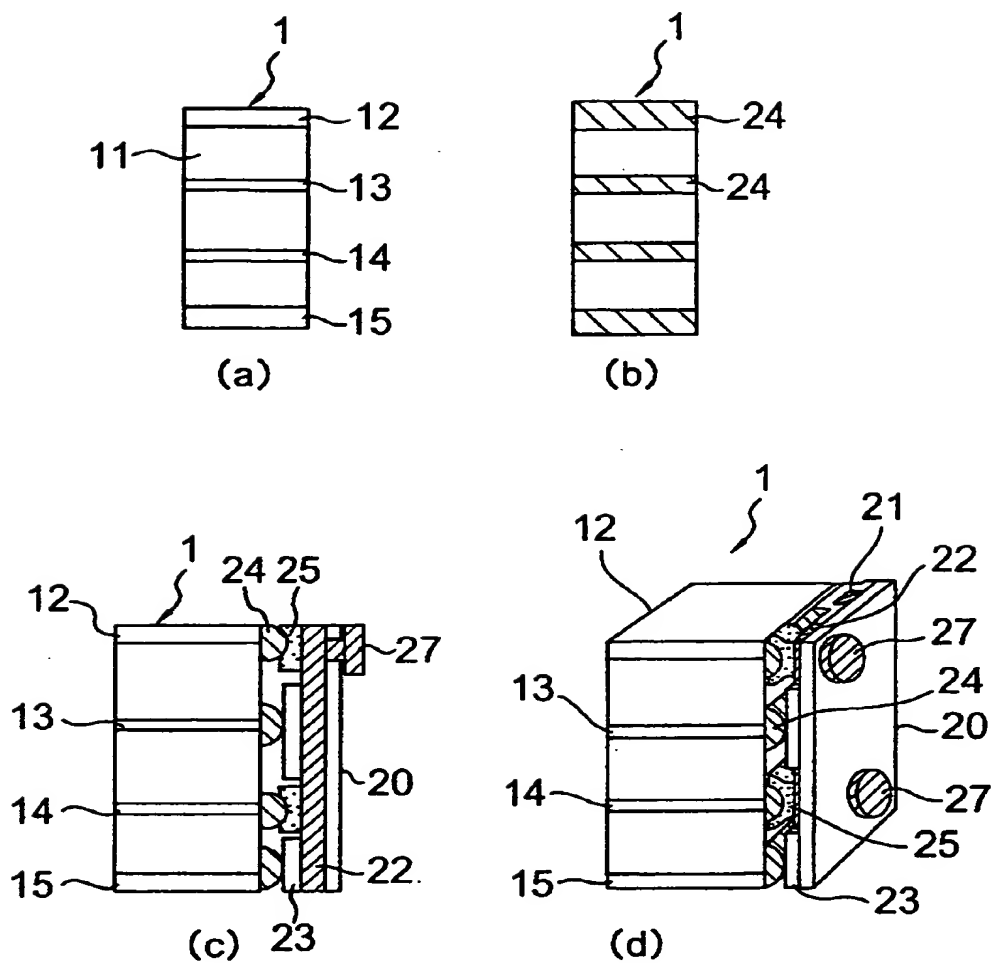
【図 5】

【図 5】



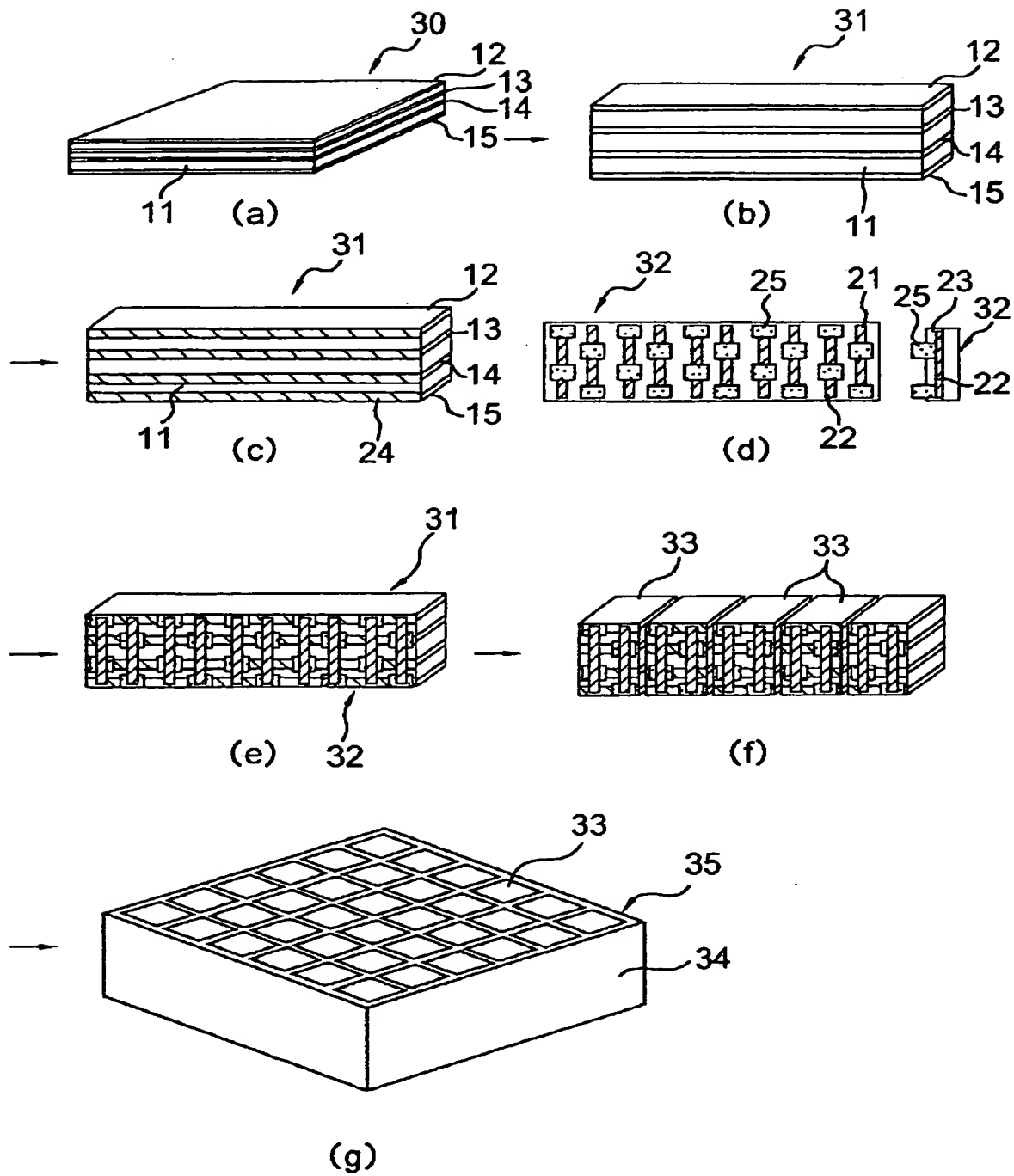
【図 6】

【図 6】



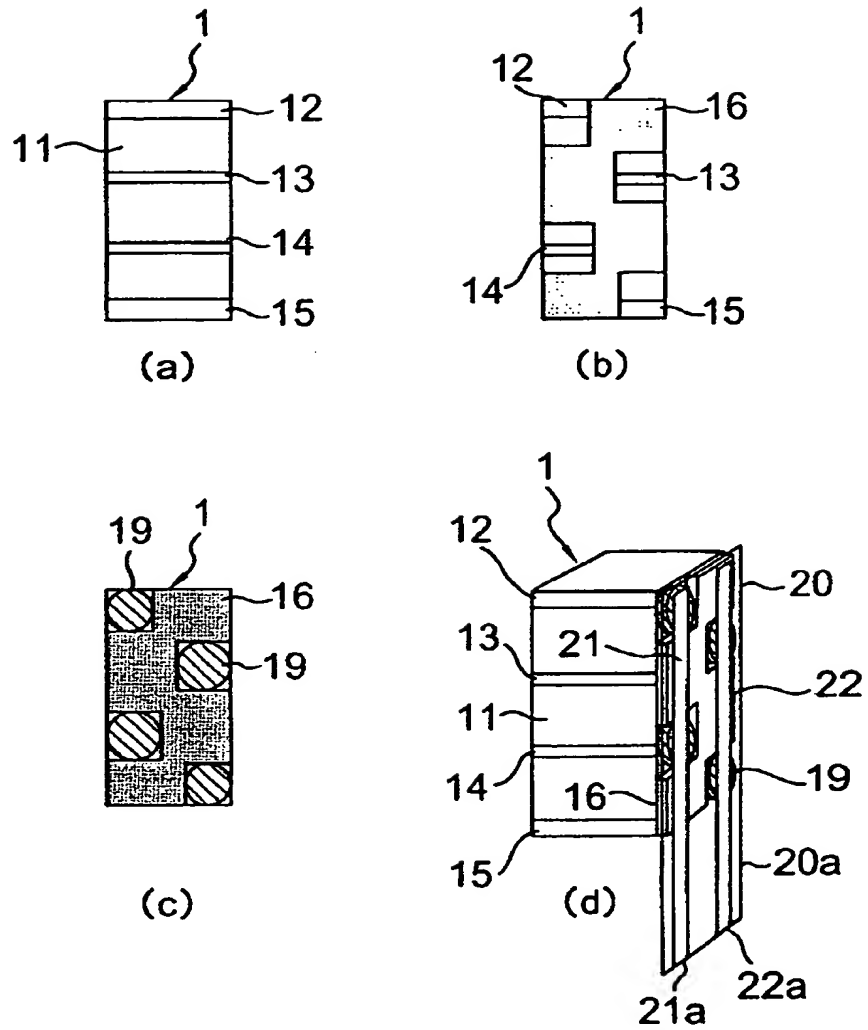
【図 7】

【図 7】



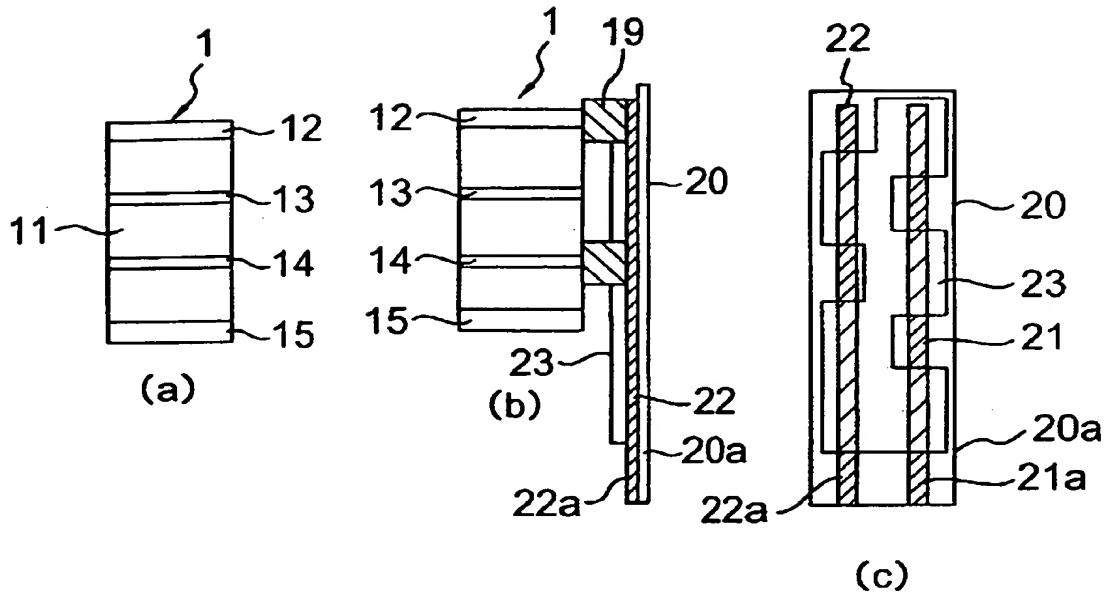
【図 8】

【図 8】



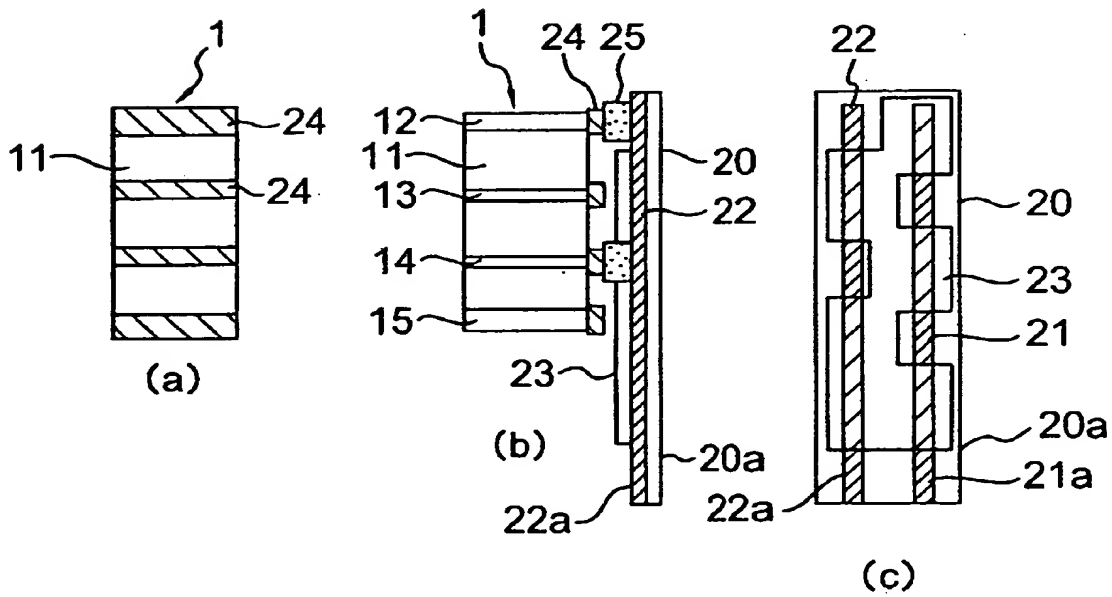
【図 9】

【図 9】



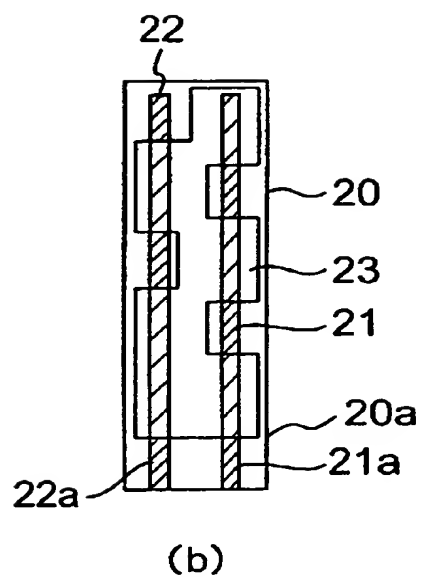
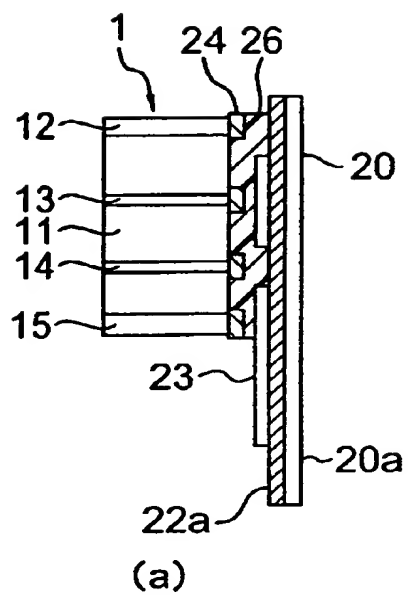
【図 10】

【図 10】



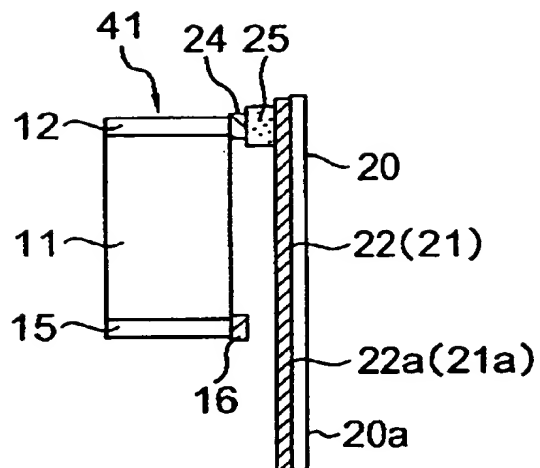
【図 1 1】

【図 1 1】



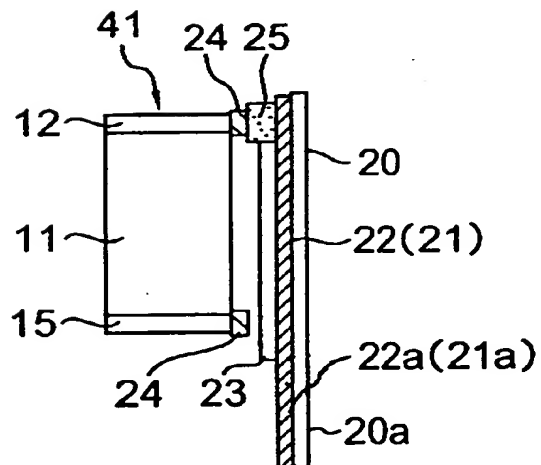
【図 12】

【図 12】



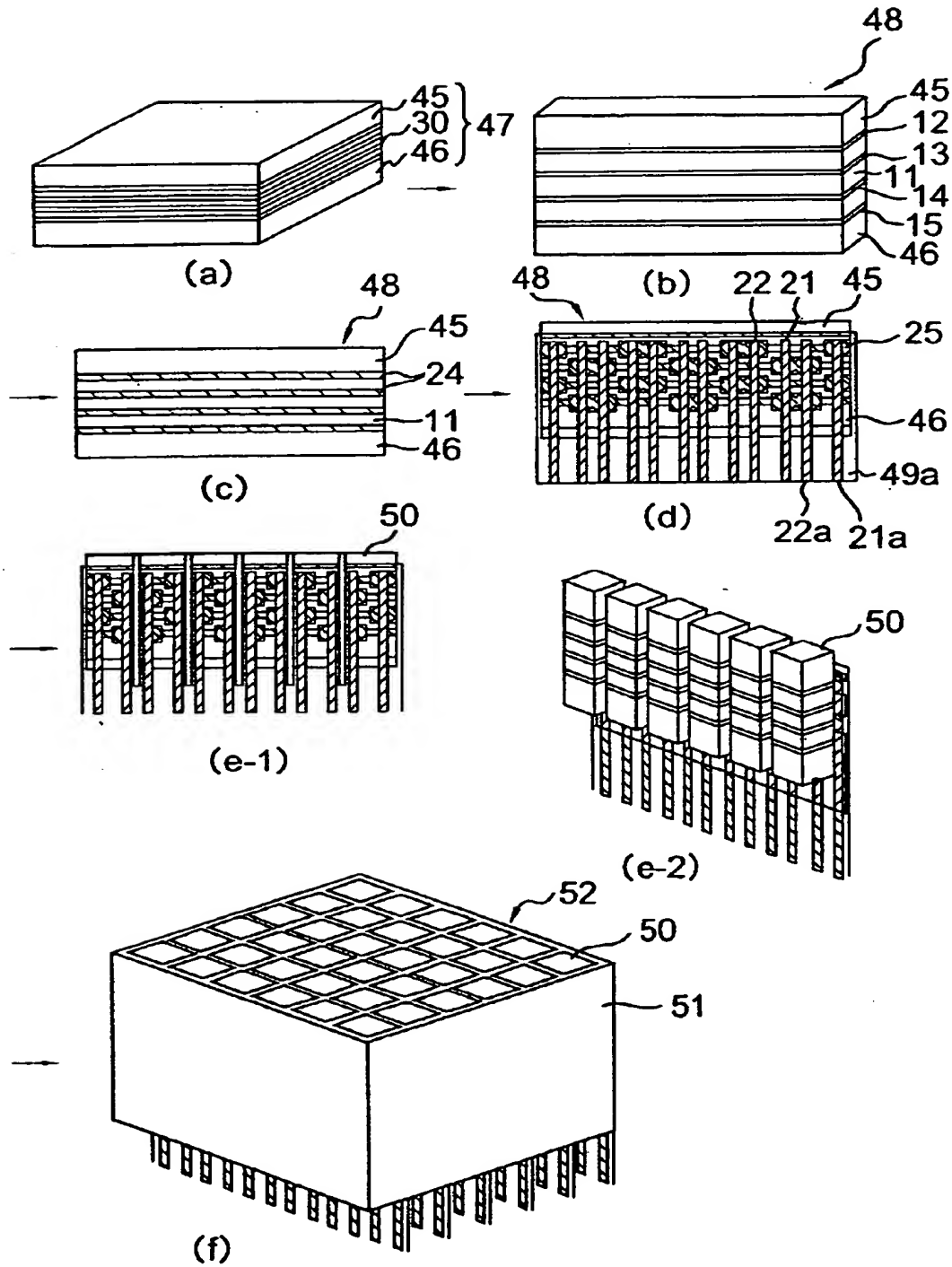
【図 13】

【図 13】



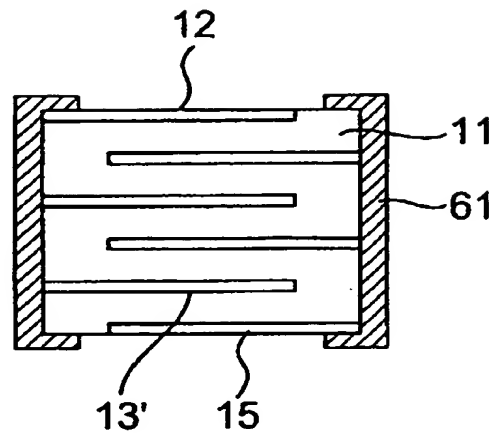
【図 14】

【図 14】



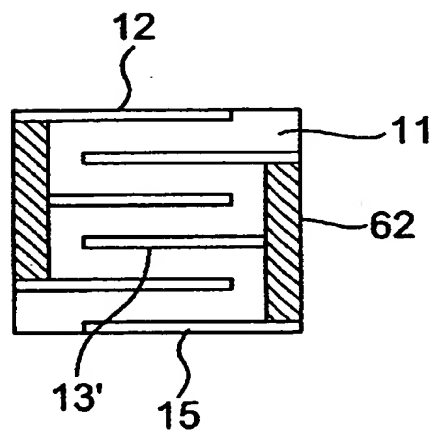
【図 15】

【図 15】



【図 16】

【図 16】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 圧電セラミック振動素子として積層型素子を用いることが可能で、かつ、素子単位で不良素子の交換および接続不良の修正が可能な、2次元アレイ状の探触子（素子実装構造）を提供することにより、また、このような素子実装構造の実現のために好適な積層電子部品を提供すること。

【解決手段】 積層電子部品を、表面電極と内部電極と裏面電極とを有する積層型のチップ状素子と、このチップ状素子の1つの側面に貼着されるフレキシブル基板とによって構成し、チップ状素子の積層方向の1つおきの電極同士を、フレキシブル基板の電極パターンによって互いに電氣的に接続して2つの電極群を形成し、この2つの電極群と電氣的に接続された2つの外部接続用電極部として、フレキシブル基板の電極パターンの端部を用いるようにされる。

【選択図】 図8

【書類名】 職権訂正データ
【訂正書類】 特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000005108
【住所又は居所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
【氏名又は名称】 株式会社日立製作所

【特許出願人】

【識別番号】 000153498
【住所又は居所】 東京都千代田区内神田1丁目1番14号
【氏名又は名称】 株式会社日立メディコ

【代理人】

申請人
【識別番号】 100078134
【住所又は居所】 東京都港区西新橋1丁目6番13号 柏屋ビル 武
特許事務所
【氏名又は名称】 武 顕次郎

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005108]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

氏 名 株式会社日立製作所

特平10-3087

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000153498]

1. 変更年月日 1990年 8月10日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都千代田区内神田1丁目1番14号
氏 名 株式会社日立メディコ